

Bruxelles, 21 novembre 2018
(OR. en)

14559/18
ADD 1

ENV 797
MI 870
DELECT 153

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	19 novembre 2018
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2018) 7499 final - Annex
Oggetto:	ALLEGATO della direttiva delegata della Commissione che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo nelle saldature destinate alla realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier all'interno dei circuiti integrati secondo la configurazione "Flip chip"

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2018) 7499 final - Annex.

All.: C(2018) 7499 final - Annex

Bruxelles, 16.11.2018
C(2018) 7499 final

ANNEX

ALLEGATO

della

direttiva delegata della Commissione

che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo nelle saldature destinate alla realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier all'interno dei circuiti integrati secondo la configurazione "Flip chip"

ALLEGATO

Nell'allegato III, la voce 15 è sostituita dalla seguente:

"15	Piombo in saldature destinate alla realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier all'interno dei circuiti integrati secondo la configurazione "Flip Chip"	Si applica alle categorie 8, 9 e 11, scade il: – 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; – 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8; – 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9 e per la categoria 11;
15 a)	Piombo in saldature destinate alla realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier all'interno dei circuiti integrati secondo la configurazione "Flip Chip" in presenza di almeno uno dei seguenti criteri: – un nodo tecnologico del semiconduttore di 90 nm o di dimensioni maggiori; – una matrice unica di 300 mm² o di dimensioni maggiori in qualsiasi nodo tecnologico del semiconduttore; – package di matrici impilate di 300 mm² o di dimensioni maggiori o interposer di silicio di 300 mm² o di dimensioni maggiori	Si applica alle categorie da 1 a 7 e alla categoria 10, scade il 21 luglio 2021".